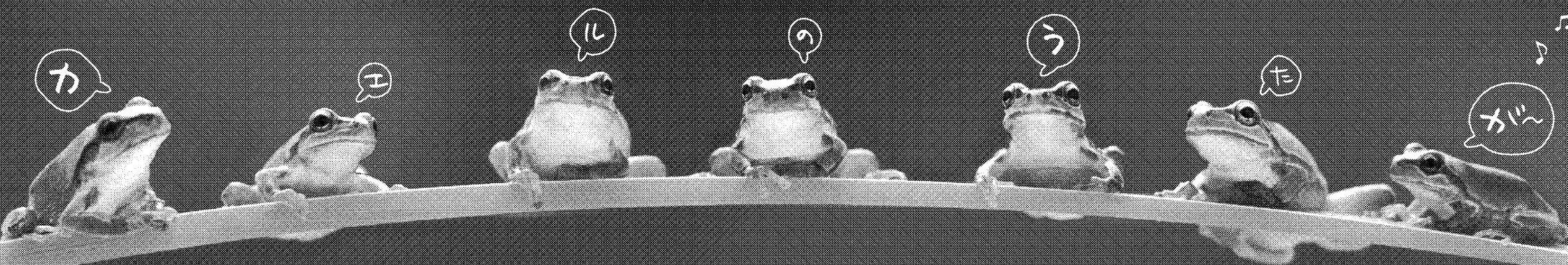


HORIBA
Explore the future



カエル合唱団、解散の危機！



あの名曲が聴けなくなる？

地球環境の悪化により、カエルが絶滅危惧種になっていることをご存知ですか？

あの名曲が、本物のカエルの声で聴けなくなる前に。

HORIBAは分析のスペシャリストとして、地球環境の保全に力を注いでいます。

株式会社 堀場製作所
www.horiba.co.jp

...ニチダイの経営基盤を築いた技術のものと。

「太い金属線を細く伸線して成形する『線引きダイス』と呼ばれる金型で、1959年に創業した。この金型を製造する事業で超硬金属や放電の加工技術を高めた。60年代以降、自動車部品の冷間鍛造用金型の需要の伸長とともに成長してきた」

...自動車用金型の用途をどのように拡大してきたのですか。

「初めはボルトやナットといった丸い形状のシンプルな部品用から手がけた。その後、技術を高度化させることにより、ギアのように複雑な形状の部品用へ次第にシフトした。顧客とともに技術課題を解決し高度な金型を開発する受注方式も築き、差別化できた。研究開発用のプレス機や試験装置も数多く備えている」

...新たな製品分野は。

「こうした鍛造金型の技術を起点に、精密鍛造部品や自動車のターボチャージャー（過

コアの鍛造技術磨く



古屋 元伸社長

給器）部品の組み立て、積層焼結金網フィルターへと広げてきた」

...今後の方針は。

「これからコア（中核）の鍛造技術を磨く。鍛造は生産やコストの効率に優れるので、鋳物部品を鍛造部品に置き換えられる用途の開発も進める。グローバル化するモノづくりへの対策も重要なテーマ。タイでの生産拠点を中心に、外需シフトやコストダウンへの対応力を強めたい」

...世界シェア45%を握る主力の半導体樹脂封止装置で、採用した新方式が評価を得ています。

「従来になかったコンセプトを打ち出したことで新たな受注につながっている。顧客の半導体メーカーは設備投資を抑えており業況見通しは厳しいが他社にない製品を持っている強みを生かし、提案活動を進めていきたい」

...装置の拡販に向け新たな施策に着手します。

「ファブレスメーカーやにも提案をはじめ、米国のグループ販売にプレス機構を置き、ファブレスメーカーと交渉して検証データをもとに生産を委託するアセンブリーハウス（半導体組み立て受託会社）に当社の装置を推奨してもらうことで、アセンブリーハウスからの受注につなげる。生産拠点が中国やマレーシアでも同様の方針を明確にした。いずれは欧州でも取り組みたい」

「米国では発光ダイオード（LED）分野でも同じ施策をとる。LEDの規格化がはじ

他に先駆け提案活動



岡田 博和社長

まるとされる2015年に向け、13年ごろからさまざまなメーカーで開発が進むと考えている。我々から先に提案していく」

...次世代の要素技術開発にも注力しています。

「セラミック素材を用いた金型を半導体業界の顧客に提案し、評価段階に入った。1円でも今期の売り上げに計上したいと受注に向けてまい進している。数年後には収益の柱になってほしい」

革新する京都の技

経営者に聞く「次代への一手」

...主力製品の界面活性剤をはじめ、さまざまな薬剤を幅広い業界に供給しています。注力する分野は。

「環境とエネルギー、電子材料、食品向け中心の生活の4分野だ。環境関連では水系の塗料用ウレタン材料を拡販する。電子材料分野では太陽電池用の導電性ペーストを強化し、紫外線（UV）や電子線（EB）を照射する硬化型樹脂も液晶などディスプレイ向けなどに展開したい」

...2012年度からの新中期経営計画では、3年で120億円の設備投資を計画しています。

「前中計期間までは利益重視でコストダウンに取り組んできたが、これからは成長を遂げないといけないという思いだ」

...同中計では、国内での技術優位性の確立を重点に置いています。

「グループを含めた四日市地区の拠点再編に取り組む。新拠点を建設し生産性を改善して価格競争力を高め市場への供給を拡大す

「殻破り12策」で成長へ



大柳 雅利社長

る。また成長のために打ち出した「殻破り12策」のひとつとして東京本社を設置し、トップセールスと情報収集を強化する」

...海外市場向けにはどうアプローチしますか。

「当面は東南アジアを主体に事業拡大し、将来的には欧州の拡大を考えたい。アジアでは既存拠点の増強が、新拠点の設置を検討している。もう少し海外売上比率を増やしていきたい」

...8月から新しい中期経営計画をスタートさせました。

「創業後、順調に業績を伸ばしてきたが、売上高が50億円を超えたあたりで足踏みしている。これを打破するには、材料開発といったコアテクノロジーの幅広い展開が欠かせない。化合物半導体や酸化物半導体はパワーデバイス、照明用途の有機EL（エレクトロルミネッセンス）などで、今後成長が期待できる」

...積極的に進める海外展開の進捗は。

「5月にベトナムでサービス拠点を設置した。東南アジア、インドでは研究機関からの引き合いが好調だ。欧州では半導体大手からの検査用生産機の受注もあり、市場深耕が期待できる。北米は販売体制を強化。地理的に遠いが、南米にも半導体や材料メーカーが潜在的な市場がある」

...中国市場は、どう見ますか。

「設備投資が回復しつつある。大きな市場だが中国への集中はリスクだろう。輸出比率

新分野にも事業展開



辻 理社長

の2割ぐらいを占めるが、もう少し落としても良い」

...設立以来の装置納入台数が3000台を超えました。

「達成に約33年かかった。顧客満足度の高い装置を作るために力を尽くしてきた。2030年度に売上高1000億円という目標を掲げており、薄膜というキー技術を軸に、ライフサイエンス・医療など新分野にも事業を展開していきたい」

ロームのSiCパワーデバイス&パワー半導体



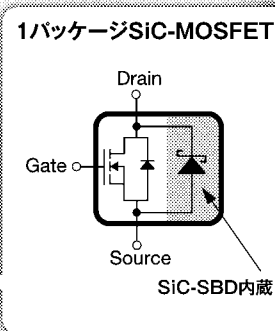
■SiCショットキーバリアダイオード(SiC-SBD)ラインアップ

品 名	絶対最大定格		電気的特性 (Ta=25℃)				パッケージ
	直流逆方向電圧 V _R (V)	順方向電流 I _F (A)	順方向電圧V _F (V)		逆方向電流I _R (μA)		
			Typ.	I _F (A)	Max.	V _R (V)	
SCS106AG/AM	600	6	1.5	6	120	600	TO-220AC 2L/ TO-220FM 2L
SCS108AG/AM	600	8	1.5	8	160	600	
SCS110AG/AM	600	10	1.5	10	200	600	
NEW SCS210AG/AM	600	10	1.35	10	200	600	
SCS112AG/AM	600	12	1.5	12	240	600	
SCS120AG	600	20	1.5	20	400	600	TO-220AC 2L
SCS105KG	1200	5	1.5	5	160	1200	
SCS110KG	1200	10	1.5	10	200	1200	
SCS120KG	1200	20	1.5	20	400	1200	
SCS120AE2	600	※10/20	1.5	10	200	600	TO-247
NEW SCS220AE2	600	※10/20	1.35	10	※200/400	600	
SCS140AE2	600	※20/40	1.5	20	※400/800	600	
SCS110KE2	1200	※5/10	1.5	5	※100/200	1200	
SCS120KE2	1200	※10/20	1.5	10	※200/400	1200	

※1端子/パッケージ

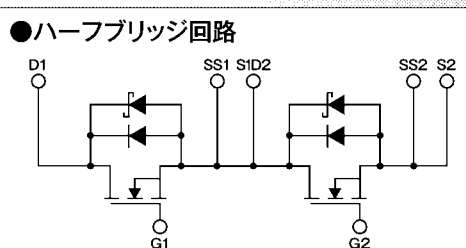
■SiC-MOSFETラインアップ

品名	BV _{DSS} (V)	R _{DS(on)} (mΩ)	パッケージ
NEW SCT2080KE (SiC-MOSFET)	1200	80	TO-247
NEW SCH2080KE (SiC-MOSFET+SiC-SBD)	1200	80	TO-247



■“フルSiC”パワーモジュール

品名	V _{DSS} (V)	I _b (A)
BSM120D12P2C005	1200	120

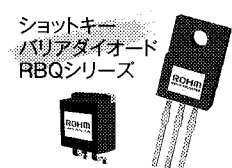
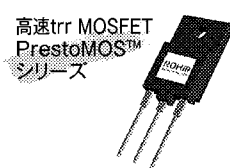
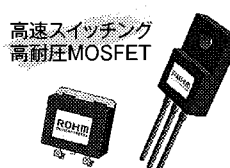
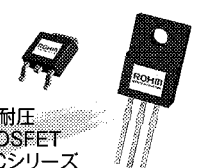


◎リカバリ時間が短い ◎ロスの少ない高速スイッチングが可能

◎インゴットからパワーデバイスまで一貫した製造・開発体制で高品質

Siパワー半導体も 続々ラインアップ

活躍領域に合わせて進化し続ける、
ロームの高性能パワーデバイス



ローム株式会社
www.rohm.co.jp
〒615-8585
京都市右京区西院清岡町21
TEL.075-311-2121

